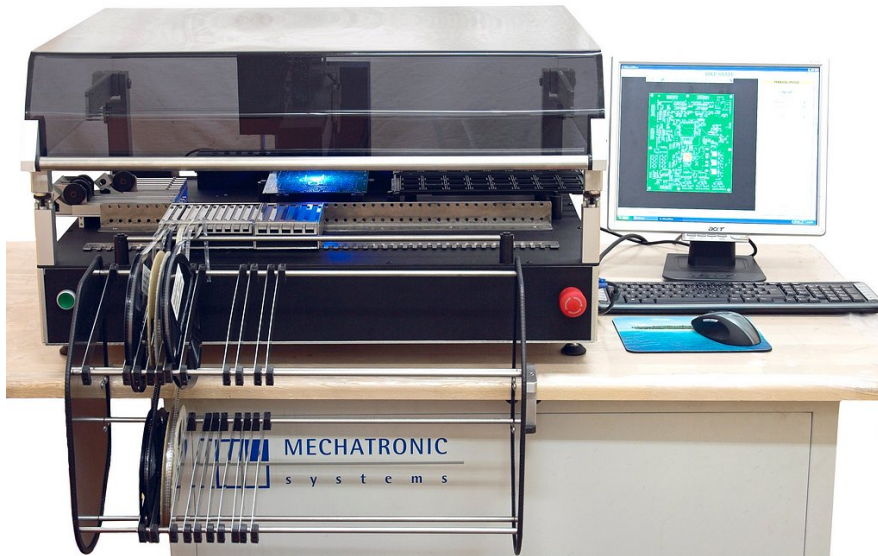


# P10 – Dispens- und SMD Bestückungsautomat mit optischer Zentrierung



## • Technische Daten

- **PCB**
  - max. Bestückungsbereich 400 x 500mm
- **Bauelementespektrum**
  - von 0402 bis zum 25x25 mm
  - Pitch min. 0,4mm
- **Bauelemente Verpackung**
  - Gurte / Stangen / Trays / Schüttgut
- **Bestückungsrate**
  - bis zu 600 B/Std.
- **Dispensrate**
  - bis zu 8000 dots/Std.
- **Zuführungen**
  - max 60 x 8mm – stripsfeeder bzw. max 40x8mm semiautomatische Gurtfeeder und
  - 2 x (300 x 200mm) - IC-Tray bei der Leiterplattengröße: 200 x 300mm
- **Auflösung**
  - X / Y Achse – 0,008mm (Längenmeßsystem )
- **Positionsgenauigkeit**
  - +/- 0,03 mm
- **Abmessungen und Gewichte**
  - 840 x 630 x 430 mm / ca. 80 kg
- **Versorgung**
  - 230 V - 50 Hz - 350 W / 0,6 Mpa -15 l/min

## • Eigenschaften

- **SMD – Bestückungsautomat mit Dispenserkopf**
- **automatischer Bestückungskopf**
- **automatischer Dispenskopf**
- **automatischer Pipettenwechsler (6-fach)**
- **Kamerasystem für automatische Referenzpunktkorrektur**
- **Kamerasystem für optische Bauelementezentrierung**
- **Kontaktloses Dispensen**
- **CAD – Editor für Gerber- und Bestückungsfiles**
- **Elektronischer Manipulator – Teach In**
- **Betriebssystem: Windows XP**
- **Graphische Bedieneroberfläche**
- **Anwendungsbereich**
  - Prototypen und Kleinsereien
  - Bestückung von Standard SMD und Finepitch-komponenten inkl. µBGA, CSP, QFN, SMD LED